

東京エレクトロン デバイス 証券コード 2760
インベスターズガイド2008

投資家の皆様へ

INVESTORS GUIDE 2008

東京エレクトロン デバイス

TOP MESSAGE



代表取締役社長 砂川 俊昭

2008年3月期は、1.コンピュータ・ネットワーク事業の強化 2.海外事業展開の推進 3.開発ビジネスの加速化 4.産業機器分野への拡販を活動方針に掲げ業容の拡大に取り組んでまいりました。

業績面では、半導体を中心とした電子部品の販売が産業機器向けに堅調に推移いたしました。また、コンピュータ・ネットワーク機器の販売も、企業のIT投資が旺盛であったことから好調に推移いたしました。その結果、売上高1,121億4百万円（前期比12.4%増）、経常利益38億4千9百万円（同18.6%増）、当期純利益21億9千3百万円（同16.9%増）と増収増益で終えることができました。

2009年3月期は、米国経済の減速等による波及懸念はありますが、半導体市場は比較的堅調に推移すると見込んでおります。また、コンピュータ・ネットワーク機器は一部でシステム投資への抑制傾向が見られますが、投資意欲には根強いものがあり、底堅い状況で推移すると見込んでおります。経費面においては、本社移転にかかわる費用やコンピュータシステムの機能強化による費用の増加を見込んでおります。これらを踏まえ、業績見通しを売上高1,150億円（前期比2.6%増）、経常利益40億2千万円（同4.4%増）、当期純利益22億1千万円（同0.8%増）といたしました。

2008年3月期の1株当たりの配当金は、中間3,300円、期末3,300円の年間6,600円（配当性向31.9%）を実施いたしました。2009年3月期も中間3,300円、期末3,300円の年間6,600円（配当性向31.7%）を予定しております。

今後も、業績の向上に努めてまいりますので、倍旧のご支援・ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

CONTENTS

トップメッセージ	01
トピックス等	02
事業紹介	03
半導体製品、電子部品他	03
コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア	07
開発ビジネス	09
マーケット情報	10
業績レビューと次期の見通し	11
財務諸表等	12
財務データ	15
会社概要・株式情報	18

PROFILE

1965 年	東京エレクトロン(株)で、電子部品の販売(フェアチャイルド社など)を開始
1990 年 9 月	東京エレクトロン デバイス(株)で電子部品の販売を開始
1998 年 7 月	東京エレクトロン(株)から電子部品に関する営業をすべて譲り受け、販売を開始
2003 年 3 月	東京証券取引所市場第二部に上場
2004 年 1 月	中国・上海に子会社の上海華桑電子有限公司(通称:東京エレクトロン デバイス上海)を設立
2005 年 1 月	中国・香港に子会社の香港華桑電子有限公司(通称:東京エレクトロン デバイス香港)を設立
2006 年10 月	東京エレクトロン(株)から、コンピュータ・ネットワーク事業を継承し、販売を開始

将来の業績見通し等に関する注意事項

このインベスチングガイドは、2008年7月1日時点で作成されています。ビジネス戦略、業績予想等の将来の見通しに関する事項は、その時点で入手可能な情報から当社の経営者の判断に基づいて書かれており、経営環境の変化により修正することがあります。したがって、当社は、内容の正確性、信頼性等、一切保証しませんので御了承下さい。最新情報については、公表資料または当社Webサイトを御参照下さい。

TOPICS

■ 本社移転

2008年8月に本社を横浜駅東口の横浜イーストスクエアに移転いたします。現在、新横浜に点在している営業拠点を本社に集約することにより、業務の効率化や社内コミュニケーションの向上を図り、一層の業容拡大に励んでまいります。なお、現在の本社（横浜市都筑区）は、エンジニアリングセンターとして活用してまいります。

■ パネトロン株式会社設立

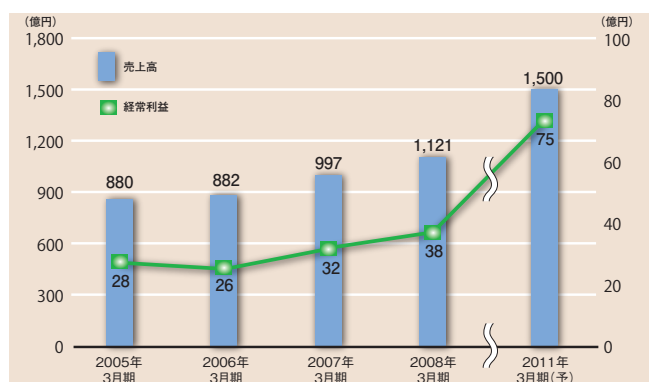
お客様のニーズに応じた商品ラインアップの充実を図ることを目的として、2008年2月に国内販売子会社であるパネトロン株式会社を設立いたしました。当面は、テキサスインスツルメンツ社の製品を販売してまいります。総合力を持つテキサスインスツルメンツ社の製品を子会社で取扱うことにより、当社グループの更なる成長につなげてまいります。

PAN

● 中期経営計画・今期の活動方針

当社グループは、2011年3月期に売上高1,500億円、経常利益75億円を目指し、売上高経常利益率5%以上を目標とする中期経営計画を公表しております。

また、2009年3月期の活動方針は右記の4点です。



(注) 2006年3月期より連結決算を開始しており、2006年3月期以降は連結数値を記載しております。

● 配当方針

当社は、株主重視を経営の最重要事項の一つと位置づけており、継続的かつ安定的な配当実施を原則としております。また、成長に応じた利益還元につきましても重視し、業績連動型配当として、連結当期純利益に対する配当性向30%を目安とすることを基本方針としております。

1. 半導体製品、電子部品他

重点戦略マーケットである産業機器分野のお客様開拓に注力し、販売強化を図ってまいります。また、伸長著しいアジアマーケットへの販売に注力し、海外事業の展開を推進してまいります。

2. コンピュータ・ネットワーク機器

成長が見込める高機能製品のマーケティングに努め、強い商品を中心としたシステム構築ビジネスを推進してまいります。

3. ソフトウェア

情報セキュリティ分野のソフトウェアを拡販してまいります。

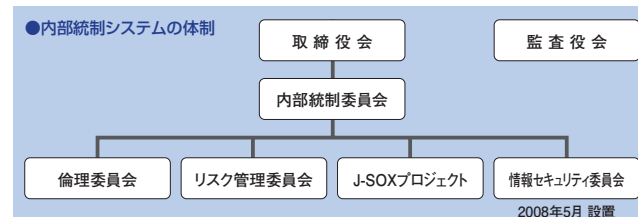
4. 開発ビジネス（インレビウム）

ICやボード製品の設計で培った技術を活用しソフトウェアも含めたシステム設計を強化していくと同時に、新規商品開発を加速させてまいります。その一環として、2007年11月に株式会社アバールデータと業務提携をいたしました。また、アジア地域への拡販活動に注力してまいります。

● コーポレート・ガバナンス

2008年3月期は、内部統制システムの体制整備に取り組んでまいりました。内部統制システム全体の整備と運用を推進する内部統制委員会のもと、倫理委員会、リスク管理委員会、J-SOXプロジェクトが、それぞれ体制整備を推進してまいりました。また、本年5月に新たに情報セキュリティ委員会を設置いたしました。

	2008年3月期		2009年3月期	
	中間	期末	中間(予定)	期末(予定)
1株当たり配当金(円)	3,300	3,300	3,300	3,300
配当性向	31.9%		31.7%	

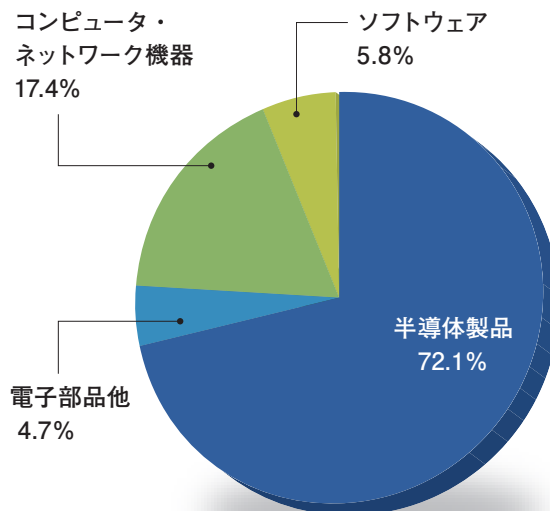


事業編

事業紹介

商品別売上構成

当社グループは、集積回路 (IC) を中心とした半導体製品、ボード製品、一般電子部品、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア等を国内外のメーカーから仕入、主に国内の大手電子機器メーカーに販売する専門商社です。

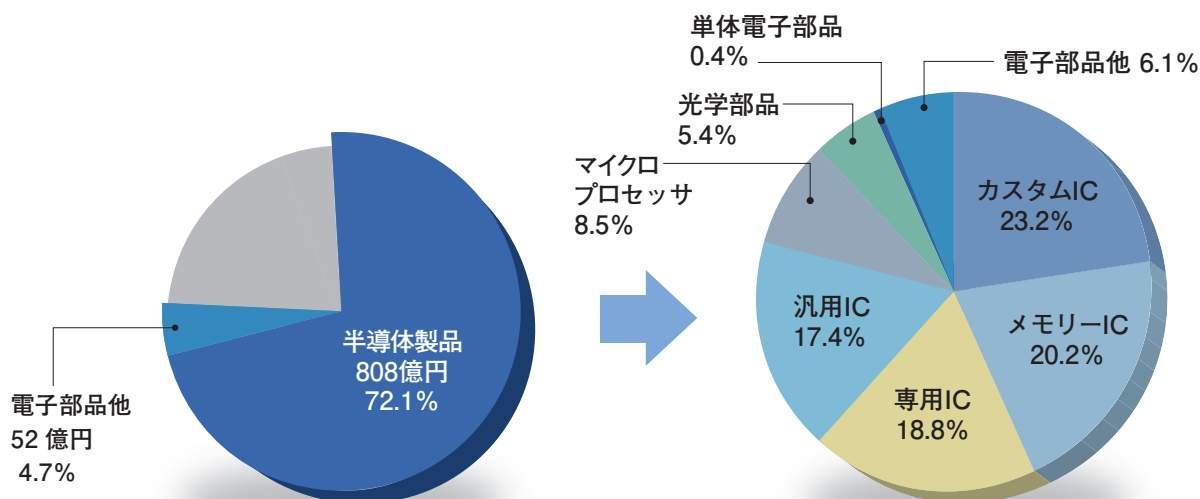
●品目別連結売上構成
(2008年3月期)

●半導体製品、電子部品他（ボード製品、一般電子部品）

●半導体製品、電子部品他の売上構成

メイン商品である半導体製品の中では、カスタムIC、専用IC、汎用アナログICなど、技術サポートを必要とする付加価値の高い商品の比率が高くなっています。2008年3月期の半導体製品の売上高は、携帯電話基地局向けカスタムICの販売は減少しましたが、携帯電話端末向け汎用アナログICの販売が堅調であり、新規の仕入先商品が寄与したこともあり、連結売上高は、808億2千8百万円（前期比1.6%増）となりました。

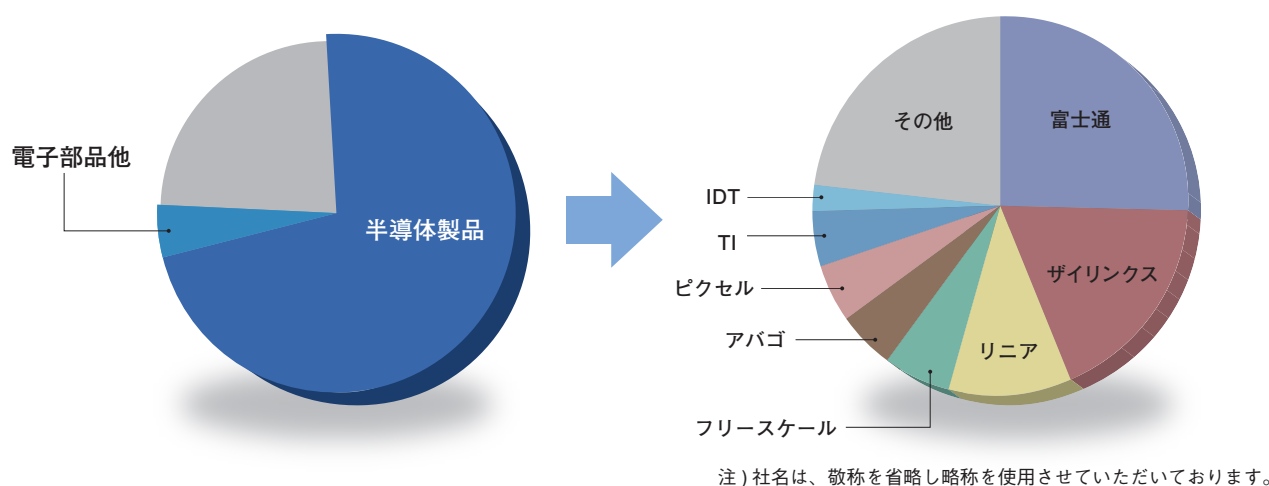
また、2008年3月期の電子部品他（ボード製品および一般電子部品）の売上高は組込み用カスタムボード等の売上高が減少したことにより、連結売上高は52億9千6百万円（前期比1.4%減）となりました。



① 仕入先の概要

世界中の電子部品メーカーに幅広くマーケティングを行い、最新の商品をラインアップしています。

● 仕入先別売上構成（2008年3月期）



② 2008年3月期 主要仕入先別売上増減要因

仕入先	増減率	要因	主要仕入先の紹介
富士通	3%	携帯電話向け伸長	電子デバイス、コンピュータ、通信機器の各分野における世界のリーディング企業。
ザイリンクス	▲ 11%	民生機器向け減少	プログラマブルロジックソリューションで世界のトップ企業。
リニアテクノロジー	6%	全ての分野で伸長	幅広い分野で利用されるアナログ IC 製品で、世界をリードする専門企業。
フリースケール・セミコンダクタ	7%	携帯電話基地局向け、医療機器向け伸長	組み込み用プロセッサの生産では世界有数の企業。幅広い半導体製品で世界をリード。
アバゴ・テクノロジー	3%	車載向け伸長	光エレクトロニクスや無線通信分野で高い実績を持つ。

③ 高付加価値の技術サポート

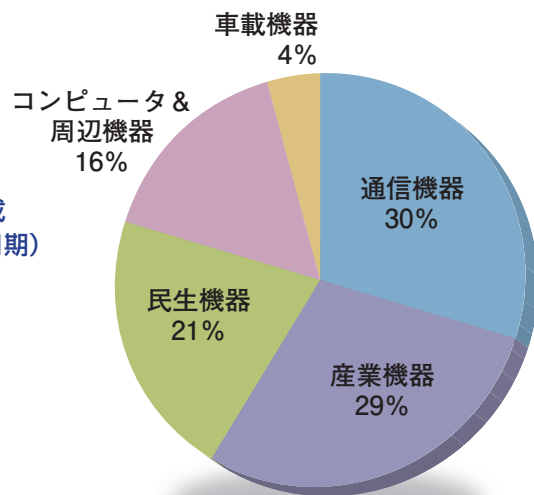
仕入先ごとに、専属のフィールド・アプリケーション・エンジニア (FAE) を配置し、企画・製造の各段階を通してきめ細かい技術サポートを行っています。お客様に対して新製品の技術説明や提案、技術問い合わせへの対応、不具合問題の解決、品質情報の提供などを行うと同時に、仕入先に対しても商品評価や技術的な調査への協力を行い、問題解決のできる技術商社として、双方から高い信頼を得ています。



事業編

● 主な用途とお客様

お客様は電子機器メーカーを中心に1,000社以上にのぼります。売上高上位は、松下グループ、東芝グループ、富士通グループ、日立グループ、NECグループなど、国内の大手電子機器メーカーが満遍なく占めています。また、当社取扱い商品は通信機器、産業機器、民生機器、コンピュータ&周辺機器などの分野に活用され、幅広い分野で実績をあげています。

● 用途別売上構成
(2008年3月期)

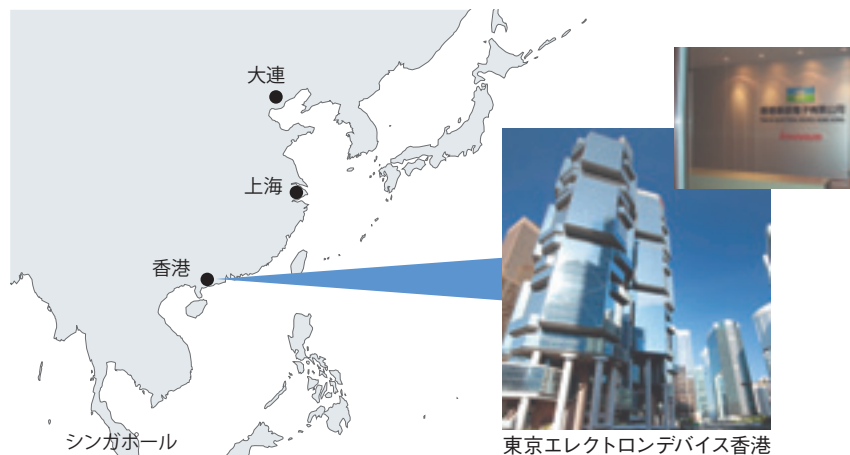
用途	主な最終製品	主なお客様
通信機器	携帯電話、ルーター、伝送装置、携帯電話基地局	NEC、日立、富士通、松下 他
産業機器	半導体試験装置、医療機器、放送機器、ロボット、計測器	アドバンテスト、東芝、松下 他
民生機器	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、薄型TV、AV機器	シャープ、ソニー、松下、ヤマハ 他
コンピュータ&周辺機器	プリンター、プロジェクター、POS、パソコン及び付属機器	エプソン、東芝、富士ゼロックス、松下 他
車載機器	カーナビゲーション、カーオーディオ	アイシン、日本精機、松下、三菱電機 他

※社名は敬称を省略し、略称を使用させていただいております。(五十音順)

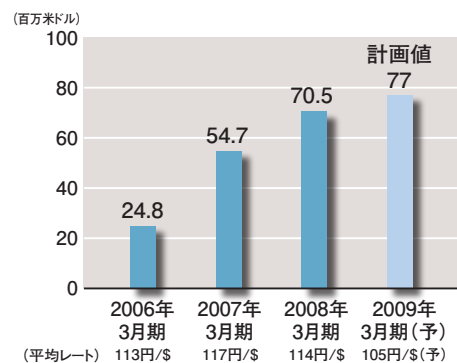
● アジア地域に、品質の高い半導体などの電子部品を提供

日系企業を主なお客様として、アジア地域に営業拠点を展開しています。2005年東京エレクトロン デバイス香港を設立以来、多言語対応、良質な物流サービスなどに注力し、上海、大連、シンガポールと拠点を増やし、2008年1月にはシンガポールを現地法人化しました。

営業開始から3年目の当期売上高は、前期比1,500万ドル増加の7,050万ドル(日本円で約80億円)となりました。2009年3月期は、売上高7,700万ドルを予定しています。



● 海外ビジネス売上高



半導体製品



カスタム IC お客様の仕様に応じて作られる固有 IC、ASIC や PLD が代表製品

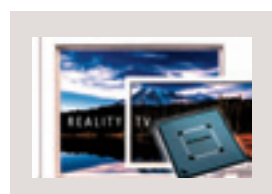
inrevium

主な商品	主な最終製品	主な仕入先（アルファベット順）
● ASIC ※1 ● PLD ※2（FPGA, CPLD）	デジタル家電／携帯電話基地局／計測器／OA 機器／放送機器／医療機器／半導体試験装置	富士通エレクトロニクス(株)、ザイリンクス社



メモリー IC 記憶専用の IC、書き込みと読み出しが可能な RAM、読み出しのみの ROM など

主な商品	主な最終製品	主な仕入先（アルファベット順）
●フラッシュメモリ ※3 ●DARAM/SRAM ●FRAM	デジタル家電／携帯電話／パソコン／計測器／OA 機器／放送機器／医療機器／半導体試験装置／カーナビゲーション	富士通エレクトロニクス(株)、アイ・ディー・ティー社、ラムトロンインターナショナル社



専用 IC 通信用や画像処理用など、特定用途向けに作られた専用の IC

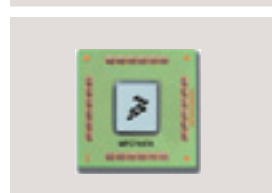
inrevium

主な商品	主な最終製品	主な仕入先（アルファベット順）
●通信・ネットワーク用 ●画像処理用 ●インタフェース用 ●セキュリティ用 ●周辺制御用	デジタル家電／OA 機器／ルーター／通信端末／プロジェクト／カーナビゲーション／監視カメラ	コネクサントシステムズ社、フリースケール・セミコンダクタ社、富士通エレクトロニクス(株)、インターシル社、ピクセルワークス社、ザーリンク・セミコンダクター社



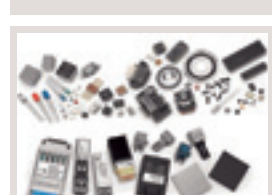
汎用 IC 色々な用途に共通して使用される IC、アナログ IC やロジック IC など

主な商品	主な最終製品	主な仕入先（アルファベット順）
●アナログ IC ●ロジック IC	携帯電話／携帯電話基地局／FA 機器／カーナビゲーション／OA 機器／半導体試験装置	リニアテクノロジー社、オン・セミコンダクター社、テキサス・インスツルメンツ社



マイクロプロセッサ コンピュータの中心となる頭脳として、演算・制御機能を持つ IC

主な商品	主な最終製品	主な仕入先（アルファベット順）
●マイクロプロセッサ ●マイクロコントローラ ●DSP	デジタル家電／携帯電話／交換機／計測器／OA 機器／放送機器、医療機器／半導体試験装置／カーナビゲーション	AMD 社、フリースケール・セミコンダクタ社、富士通エレクトロニクス(株)、テキサス・インスツルメンツ社



光学部品 電気を光に変換して使用する電子部品

主な商品	主な最終製品	主な仕入先（アルファベット順）
●LED ※4 ●フォトカプラ ※5 ●光ファイバー ●IrDA ※6	交換機／携帯電話／FA 機器／パソコン	アバゴ・テクノロジー社、ユーディナデバイス(株)



単体電子部品 増幅や整流など、電気の基本機能を持つ部品

主な商品	主な最終製品	主な仕入先（アルファベット順）
●ダイオード ※7 ●トランジスタ	携帯電話／パソコン／OA 機器	オン・セミコンダクター社

電子部品 他

inrevium



主な商品	主な最終製品	主な仕入先（アルファベット順）
●CPU ボード ●インタフェースボード ●評価ボード ●組込みボード ●パネル PC ●LCD ※8 ●電源 ●コネクタ ●IC ソケット	サーバ／FA 機器／医療機器／計測器／半導体製造装置／ロボット	コーセル(株)、ダイアロジック社、(株)デジタル、(株)PFU

※1【ASIC】高性能が望めるが、開発期間が長くかかるカスタム IC。
 ※2【PLD】プログラム可能な論理素子のカスタム IC。ASIC より短期開発が可能。
 ※3【フラッシュメモリ】データを電氣的に保存するメディア。電源が切れても保持が可能。
 ※4【LED】電流を流すと発光するダイオード。ランプや表示器に使用。

※5【フォトカプラ】電気信号を光に変換して伝達する素子。電氣的な絶縁が利点。
 ※6【IrDA】規格団体により制定された赤外線使用の通信機能。モバイル機器などで使用。
 ※7【ダイオード】電流を一方方向のみに流す整流作用を持つ電子部品。
 ※8【LCD】液晶を使用したディスプレイ。ノート PC などに使用。

事業編

● コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア

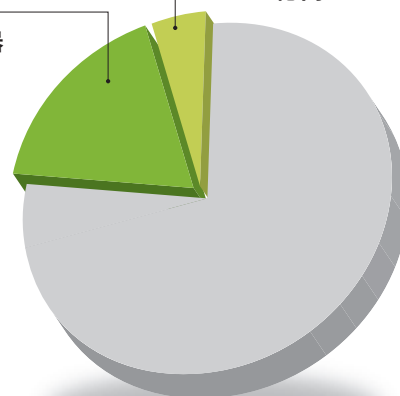
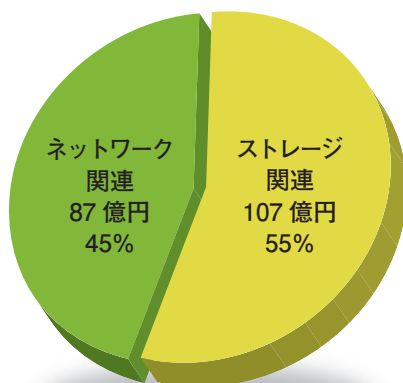
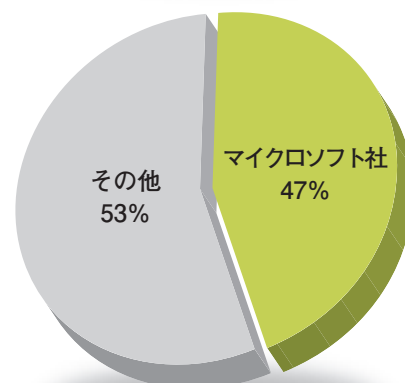
① コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェアの売上構成

2006年10月より、新たに取扱いを開始したコンピュータ・ネットワーク機器につきましては、企業における保存データ量の増加を背景として、SAN(ストレージ・エリア・ネットワーク)スイッチの販売が好調であり、企業向けネットワークシステム構築機器の販売及び保守が堅調に推移したことにより、売上高は195億2千万円(前期比113.1%増)となりました。ソフトウェアに関しては、主に官公庁向けビジネスが好調であったため、売上高は64億5千9百万円(前期比14.6%増)となりました。

● 品目別売上構成

コンピュータ・
ネットワーク機器
195億円 17.4%

ソフトウェア
64億円 5.8%

● コンピュータ・ネットワーク機器
分野別内訳● ソフトウェア
仕入先別内訳

② コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェアの特徴

主に米国から差別化が可能な最先端技術を探し出し、国内に投入

日本での販売促進、保守サポート、品質保証を当社が担う

技術的に難しい複合システムを構築し、お客様へ提供

③ 注力分野

F5 ネットワーク社を中心としたシステム構築ビジネスの推進

内部統制向けストレージ関連製品、ソフトウェア製品の拡販

保守運用サポートビジネスの拡大

品質保証体制

製品品質、サポート品質、技術品質、お客様、パートナー様の満足と信頼性の向上を目指します。たとえば、入荷検査、出荷調整、品質管理、品質改善、検証作業、データ解析を専門組織が対応。安心してご使用頂けるよう保守サービス、製品保証を用意しています。



コンピュータ・ネットワーク機器



ストレージソリューション SAN (ストレージ・エリア・ネットワーク) スイッチ、SAN 接続機器、ストレージセキュリティ機器など

主な商品

- SAN ファブリックスイッチ
- バックアップアプライアンス
- テープライブラリ
- ファイバーチャネルホストバスアダプタ
- クラスタ・ストレージ
- ストレージセキュリティアプライアンス

主な仕入先 (アルファベット順)

- ブロカードコミュニケーションズシステムズ社
- データドメイン社
- エミュレックス社
- アイシロン・システムズ社
- クアンタム社
- ストアウィズ社
- シマンテック社



ネットワークソリューション インターネット接続機器 (負荷分散、セキュリティ)、企業向けネットワークシステム構築機器など

主な商品

- アプリケーショントラフィックマネージャ
- LAN スイッチ
- ファイアウォール
- VPN アプライアンス
- ハードウェアセキュリティモジュール

主な仕入先 (アルファベット順)

- アラクサラネットワークス(株)
- エクストリーム ネットワークス社
- F5 ネットワークス社
- インバーバ社
- インフォブロックス社
- ジュニパーネットワーク社
- エンサイファー社
- セキュアコンピューティング社

ソフトウェア

inrevium



主な商品

- OS
- BIOS ※ 1
- 開発ツール
- インメモリ・データベース
- 組込みデータベース・エンジン
- ログ長期保存・分析・ツール

主な最終製品

- POS
- 周辺装置
- FA 機器
- OA 機器
- セキュリティ製品
- 社内 LAN
- カーナビゲーション

主な仕入先 (アルファベット順)

- アーデンス社
- マイクロソフト社
- 日本オラクル(株)
- フェニックステクノロジーズ社
- センセージ社

※ 1 【BIOS】 キーボードやディスプレイなど基本的なデバイスを制御するソフトウェア。

事業編

開発ビジネス

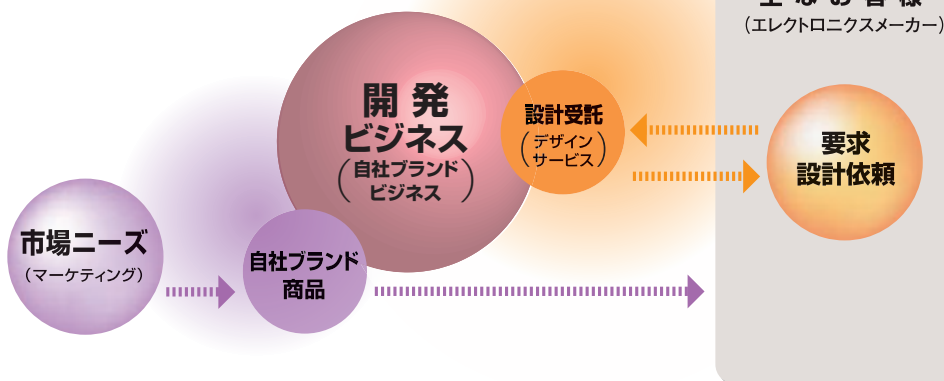
商社ではありますが、自社ブランド商品の設計・開発も手掛けており、メーカーとしての側面も持っています。

開発ビジネス(自社ブランドビジネス)は、お客様の要求に

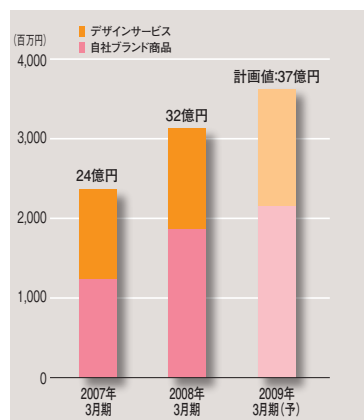
inrevium

2004年6月、開発ビジネスについて自社ブランド「inrevium(インレビウム)」を命名しました。InreviumはIntellectual(知的な)、Revolutionary(革新的な)、ium(要素)などの単語の一部を組み合わせた造語です。当社が持つ情報・技術・サービスなどの商品化を通じて、お客様の抱える課題を解決し、事業活動に貢献していきたいとの強い意味が込められています。

基づきカスタムICやボードの設計を行う設計受託業務(デザインサービス)と市場ニーズに沿った商品の企画開発を行う自社ブランド商品で構成されています。



●インレビウム売上高推移



自社ブランド商品 (inrevium プロダクト)

長年培ってきた販売、設計・開発、マーケティング等の経験を活かして、お客様のニーズにフィットした自社ブランド商品を開発しています。画像処理やメモリ制御技術、通信インタフェース技術など当社保有の技術を活用した商品など、現在、60種類以上の商品・サービスを提供しています。



設計受託 (inrevium デザインサービス)

お客様の設計工数を削減すると同時に、経験豊富な専門家に任せることで、設計リスクの軽減や最新技術の活用、設備投資や維持費の低減などが容易に行え、しかも開発期間の短縮による商品の早期完成が可能になります。



設計開発センター (inrevium 開発センター)

1985年に開設された設計開発センターでは、豊富な設計・開発の経験と、常に最新の技術動向を先取りした設備の導入により、自社ブランド商品の開発やお客様の要求に基づくデザインサービスを、スピーディかつ効率的に実現し、新商品の市場投入を短期間に安価で行うことを支援しています。現在、設計開発センターは日本の横浜と仙台、中国の上海と無錫の4箇所にあります。

また、この商品開発経験が、商社ビジネスの営業提案や技術サポートに活かされることにより、No.1技術商社ならではのシナジー効果を創出しています。



データ編

マーケット情報

① 世界の半導体市場動向

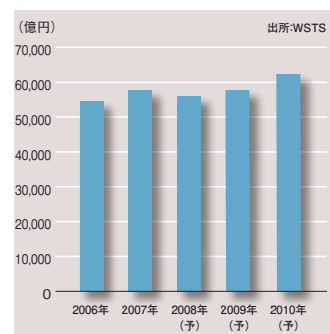


ドルベースでの伸び率は、2007年は2006年の堅調な市場拡大(+8.9%)を下回り、年率では前年比+3.2%(2,556億ドル)となりました。その後2008年は+4.7%と伸長が緩やかなものに留まるものの、2009年は+5.8%と伸長を継続し、2010年には+8.8%と堅調な成長を示すものと予測されています。この結果、2007年から2010年

までの年平均成長率は+6.4%となります。

2008年の世界の半導体市場規模は2,677億ドル(28兆2千4百億円)、前年比120億5,000ドル増となり、2007年に達成した過去最大の市場規模を更に続伸すると予測されています。

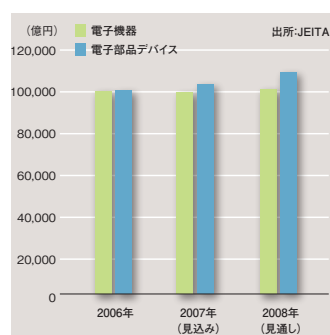
② 日本の半導体市場動向



日本の半導体市場伸び率は、円ベースで2007年は2006年の堅調な成長(+11.3%)に対し前年比+6.4%と鈍化し、2008年は前年比-3.8%と前年を割るものと予測されています。その後2009年は前年比+3.6%、2010年は前年比+7.1%と緩やかに回復すると予測されています。その結果、

日本の半導体市場規模は、2007年は約5兆7千5百億円でしたが、2008年は約5兆5千3百億円、2009年は約5兆7千3百億円、2010年は約6兆1千4百億円となり、2007年から2010年までの年平均成長率は+2.2%となるものと予測されています。

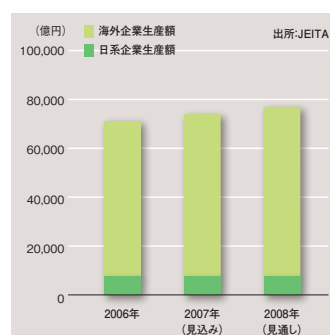
③ 日本の電子工業生産



2008年の電子工業における国内生産総額は、21兆2,984億円(前年比+3%)と3年連続のプラス成長が予測されています。米国サブプライムローン問題の深刻化や原油高など世界経済への懸念材料があることや、グローバル市場での低価格化等不透明感があるものの、一方では、北京オリンピック開催に伴う薄型テレビへの買替需要や、新興国の経済成長に伴うデジタル製品の拡大が期待できることから、半導体等の電子部品

デバイスは前年比+5%と高い成長を見込み、全体でも堅調な伸びが予測されています。電子工業全体では、日系企業の国内生産比率は46%と、海外生産へと移行が進む中、特に高度な信頼性や品質を要求される分野で高い水準を維持すると予測されています。2008年の日系企業の国内生産比率の高い製品分野は、半導体(日系国内生産比率77%)、サーバ・ストレージ(同76%)、電気計測器(同72%)と予測されています。

④ サーバ・ストレージ世界および国内生産動向



2007年におけるサーバ・ストレージの世界生産額は7兆3,992億円、世界生産額に占める日系企業生産の割合は約10%にあたる7,353億円でした。このうち国内生産比率は76%と見込まれています。

世界の生産動向は、ここ数年、世界的にIT分野に対する投資は拡大する傾向にあり、安定した成長率が見られ、市場はメインフレームからオープンサーバへの需要転換等の影響を受けるものの、ネットワーク化の更

なる進展や情報セキュリティへの対応等があり、今後も緩やかな成長が続くと予測されています。

国内生産動向は、オープンサーバの性能向上やレガシーシステムの見直しの中でサーバは減少傾向にあるものの、大規模ストレージ需要もあり、ストレージ装置の生産増等を含めてサーバ・ストレージ全体では横ばいと予測されています。

データ編

業績レビューと次期の見通し

① 当期（2008年3月期）の業績報告

当期におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に、緩やかな回復基調を続けてまいりましたが、サブプライムローン問題等による米国の景気減速感が強まる中、原材料価格の高騰と相俟って、国内景気に対する先行きが懸念される状況となっています。

当社グループの参画しているエレクトロニクス業界においては、ノート型パソコンや携帯電話が出荷台数ベースで堅調に推移しました。薄型テレビ（PDP・液晶）やデジタルカメラ等のデジタル家電につきましては、需要が旺盛でありましたが、引き続き価格低下が進み、競争は激しさを増しています。また、年度後半から世界経済の景況感が悪化したことを受け、半導体市場も弱含みの状況で推移しています。一方、企業における情報セキュリティや内部統制関連の法整備を背景として、情報セキュリティ対策や保存データ量の増加に対応するためのIT投資が引き続き堅調に推移しています。

このような状況のもと当社グループは、重点戦略マーケットで

ある産業機器分野向けに、カスタムICや汎用IC（アナログIC）等の高付加価値商品の販売に注力し、自社ブランド「inrevium（インレビウム）」ビジネスでは、半導体の設計受託業務拡大と自社商品開発強化に努めてきました。また、顧客企業戦略に最適なソリューションを提供すべく、コンピュータ・ネットワーク機器及びIT関連ソフトウェアの販売並びに保守サービスの強化に努めてきました。拠点展開におきましては、2008年1月には海外事業戦略の一環として、ASEAN地域における販売体制強化のためシンガポールに子会社を、また、2008年2月には顧客ニーズに応じた商品ラインアップの充実を図るため国内に子会社を設立し、顧客に密着した営業展開を図ってきました。

この結果、2008年3月期の売上高は1,121億4百万円（前期比12.4%増）、営業利益は36億7千8百万円（前期比4.2%増）、経常利益は38億4千9百万円（前期比18.6%増）、当期純利益は21億9千3百万円（前期比16.9%増）となりました。

② 次期の見通し

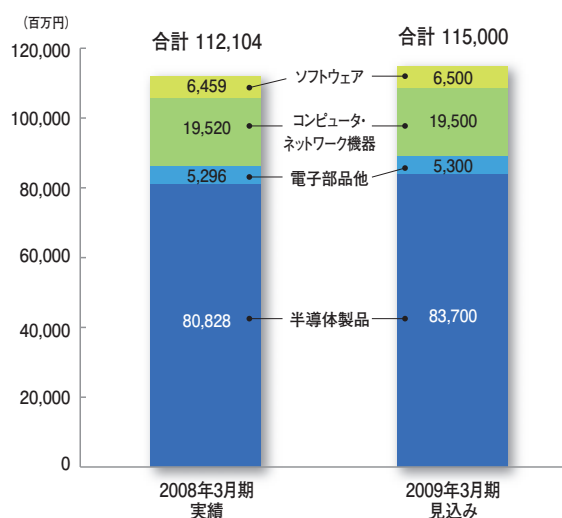
今後の見通しにつきましては、サブプライムローン問題等による米国の景気減速や原油価格・原材料価格の高騰による世界経済の先行き不透明感を受け、国内経済につきましても、これまでの成長が鈍化する恐れがあるものと見込まれます。

当社グループが参画いたしておりますエレクトロニクス業界におきましても、デジタル家電の価格競争は続くものとみられ、これまで堅調であったIT投資を含めた設備投資につきましても先行き

が不透明な状況にあります。

こうした状況のもと、当社グループは、顧客ニーズに応じた商品ラインアップの一層の充実を図り、業績の向上に努めてまいります。2009年3月期の連結業績見通しにつきましては、売上高1,150億円（前期比2.6%増）、営業利益43億5百万円（前期比17.0%増）、経常利益40億2千万円（前期比4.4%増）、当期純利益22億1千万円（前期比0.8%増）を見込んでいます。

● 2009年3月期 品目別 連結売上高予想



● 2009年3月期 連結業績予想

(単位：百万円)	上期予想	下期予想	通期
売上高	54,600	60,400	115,000
営業利益	1,560	2,745	4,305
経常利益	1,410	2,610	4,020
当期純利益	715	1,495	2,210



連結財務諸表

連結貸借対照表

資産の部	前 期	当 期
	(2007年3月31日現在)	(2008年3月31日現在)
	千円	千円
流動資産	43,387,749	47,005,467
現金及び預金	1,142,667	1,367,624
受取手形及び売掛金	23,361,816	25,633,561
たな卸資産	16,888,548	17,649,887
繰延税金資産	482,330	624,533
未収消費税等	530,177	811,642
その他	988,878	929,676
貸倒引当金	△ 6,670	△ 11,458
固定資産	3,341,910	4,453,012
有形固定資産	1,019,858	1,012,699
建物及び構築物	559,814	550,745
工具、器具及び備品	460,043	461,954
無形固定資産	227,334	785,538
投資その他の資産	2,094,717	2,654,774
投資有価証券	59,025	119,797
繰延税金資産	1,497,022	1,401,918
その他	543,766	1,141,758
貸倒引当金	△ 5,097	△ 8,699
資産合計	46,729,660	51,458,480

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

資産

資産総額は514億5千8百万円となり、前期末に比べ47億2千8百万円の増加となりました。これは主に、売上債権、たな卸資産が増加したことによります。

負債

負債総額は298億5千3百万円となり、前期末に比べ31億8千万円の増加となりました。これは主に、短期借入金、仕入債務が増加したことによります。

負債の部	前 期	当 期
	(2007年3月31日現在)	(2008年3月31日現在)
	千円	千円
流動負債	22,718,370	25,584,200
買掛金	12,888,266	13,897,701
短期借入金	1,351,399	6,069,679
一年以内返済予定長期借入金	3,000,000	—
未払金	1,784,735	1,582,518
未払法人税等	999,943	1,043,627
賞与引当金	824,157	663,307
役員賞与引当金	26,000	44,550
その他	1,843,867	2,282,815
固定負債	3,954,829	4,269,405
退職給付引当金	3,615,122	3,859,577
役員退職慰労引当金	111,907	129,928
その他	227,800	279,900
負債合計	26,673,199	29,853,605
純資産の部		
株主資本	20,054,514	21,579,799
資本金	2,495,750	2,495,750
資本剰余金	5,645,240	5,645,240
利益剰余金	11,913,524	13,438,808
評価・換算差額等	1,945	25,074
その他有価証券評価差額金	△ 115	△ 5,420
繰延ヘッジ損益	△ 1,502	64,622
為替換算調整勘定	3,564	△ 34,127
純資産合計	20,056,460	21,604,874
負債及び純資産合計	46,729,660	51,458,480

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

純資産

純資産総額は216億4百万円となり、前期末に比べ15億4千8百万円の増加となりました。これは主に、当期純利益の計上により利益剰余金が増加したことによります。

データ編



連結財務諸表

連結損益計算書

科 目	前 期	当 期
	2006年4月1日から 2007年3月31日まで	2007年4月1日から 2008年3月31日まで
	千円	千円
売上高	99,743,143	112,104,644
売上原価	85,636,961	95,147,030
売上総利益	14,106,181	16,957,614
販売費及び一般管理費	10,575,028	13,278,745
給料手当	3,633,426	4,560,679
賞与引当金繰入額	826,577	651,225
役員賞与引当金繰入額	26,000	44,550
退職給付引当金繰入額	572,512	573,239
その他	5,516,512	7,449,050
営業利益	3,531,153	3,678,869
営業外収益	40,729	428,745
受取利息	2,495	2,189
受取配当金	5,675	—
為替差益	—	394,956
セミナー開催収入	7,218	6,173
受取保険配当金	14,793	18,226
その他	10,546	7,201
営業外費用	326,335	258,348
支払利息	95,152	80,833
債権譲渡損	169,433	167,732
為替差損	51,449	—
その他	10,300	9,782
経常利益	3,245,547	3,849,269
特別利益	1,684	133
固定資産売却益	—	133
貸倒引当金戻入益	1,684	—
特別損失	5,951	21,437
固定資産売却損	102	—
固定資産除却損	5,849	7,507
事務所原状回復費用	—	13,930
税金等調整前当期純利益	3,241,280	3,827,964
法人税、住民税及び事業税	1,539,969	1,723,550
法人税等調整額	△ 175,435	△ 88,669
当期純利益	1,876,746	2,193,084

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	前 期	当 期
	2006年4月1日から 2007年3月31日まで	2007年4月1日から 2008年3月31日まで
	千円	千円
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	3,241,280	3,827,964
減価償却費	287,504	364,982
貸倒引当金の増減額	△ 1,684	9,666
賞与引当金の増減額	346,763	△ 158,364
役員賞与引当金の増減額	26,000	18,550
退職給付引当金の増減額	70,069	244,454
役員退職慰労引当金の増減額	15,511	18,021
受取利息及び受取配当金	△ 8,171	△ 2,189
支払利息	95,152	80,833
為替差損益	169	1,491
有形固定資産売却損益	102	△ 133
有形固定資産除却損	5,849	7,507
売上債権の増減額	△ 1,507,127	△ 2,465,392
たな卸資産の増減額	730,265	△ 859,855
仕入債務の増減額	△ 649,981	1,202,636
未収消費税等の増減額	154,550	△ 281,497
その他	78,671	134,729
小計	2,884,927	2,143,405
利息及び配当金の受取額	8,171	2,189
利息の支払額	△ 95,020	△ 83,028
法人税等の支払額	△ 1,143,199	△ 1,680,815
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,654,878	381,751
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 150,304	△ 373,581
有形固定資産の売却による収入	1,914	399
無形固定資産の取得による支出	△ 63,854	△ 598,530
投資有価証券の取得による支出	△ 59,220	△ 69,702
貸付けによる支出	△ 600	—
その他	△ 129,365	△ 214,535
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 401,430	△ 1,255,951
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額	△ 350,173	4,801,944
長期借入金の返済による支出	—	△ 3,000,000
配当金の支払額	△ 552,000	△ 667,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 902,173	1,134,144
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 7,265	△ 34,987
現金及び現金同等物の増減額	344,009	224,956
現金及び現金同等物の期首残高	798,658	1,142,667
現金及び現金同等物の期末残高	1,142,667	1,367,624

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書

	株主資本				評価・換算差額等				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計	
									千円
2007年3月31日残高	2,495,750	5,645,240	11,913,524	20,054,514	△ 115	△ 1,502	3,564	1,945	20,056,460
連結会計年度中の変動額									
剰余金の配当			△ 667,800	△ 667,800					△ 667,800
当期純利益			2,193,084	2,193,084					2,193,084
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)					△ 5,304	66,125	△ 37,691	23,129	23,129
連結会計年度中の変動額合計	—	—	1,525,284	1,525,284	△ 5,304	66,125	△ 37,691	23,129	1,548,414
2008年3月31日残高	2,495,750	5,645,240	13,438,808	21,579,799	△ 5,420	64,622	△ 34,127	25,074	21,604,874

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別財務諸表

個別貸借対照表

資産の部	当 期 (2008年3月31日現在)	負債の部	当 期 (2008年3月31日現在)
	千円		千円
流動資産	45,967,587	流動負債	24,765,894
現金及び預金	1,130,084	買掛金	13,629,395
受取手形	523,075	短期借入金	5,600,000
売掛金	24,940,231	未払金	1,561,816
商品	17,125,926	未払費用	183,168
前渡金	382,099	未払法人税等	997,040
前払費用	125,162	前受金	1,991,655
繰延税金資産	622,037	預り金	49,186
未収消費税等	811,418	前受収益	56,639
その他	310,112	賞与引当金	652,443
貸倒引当金	△ 2,562	役員賞与引当金	44,550
		その他	—
固定資産	4,521,684	固定負債	4,269,405
有形固定資産	999,861	退職給付引当金	3,859,577
建物及び構築物	550,744	役員退職慰労引当金	129,928
工具、器具及び備品	449,116	その他	279,900
無形固定資産	782,016	負債合計	29,035,299
投資その他の資産	2,739,806	純資産の部	
投資有価証券	50,095	株主資本	21,394,770
繰延税金資産	1,448,801	資本金	2,495,750
その他	1,240,909	資本剰余金	5,645,240
資産合計	50,489,272	利益剰余金	13,253,779
		評価・換算差額等	59,202
		その他有価証券評価差額金	△ 5,420
		繰延ヘッジ損益	64,622
		純資産合計	21,453,972
		負債及び純資産合計	50,489,272

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別損益計算書

科 目	当 期 2007年4月1日から 2008年3月31日まで
	千円
売上高	109,295,862
売上原価	92,775,890
売上総利益	16,519,971
販売費及び一般管理費	13,040,199
役員報酬	184,650
従業員給料手当	4,302,823
従業員賞与	861,969
賞与引当金繰入額	628,452
退職給付引当金繰入額	573,239
減価償却費	362,269
研究開発費	125,158
その他	6,001,636
営業利益	3,479,772
営業外収益	406,359
受取利息	1,407
為替差益	366,499
セミナー開催収入	6,173
受取保険配当金	18,226
その他	14,052
営業外費用	240,083
支払利息	62,569
債権譲渡損	167,732
その他	9,782
経常利益	3,646,048
特別利益	1,016
特別損失	21,437
税引前当期純利益	3,625,627
法人税、住民税及び事業税	1,686,661
法人税等調整額	△ 139,245
当期純利益	2,078,211

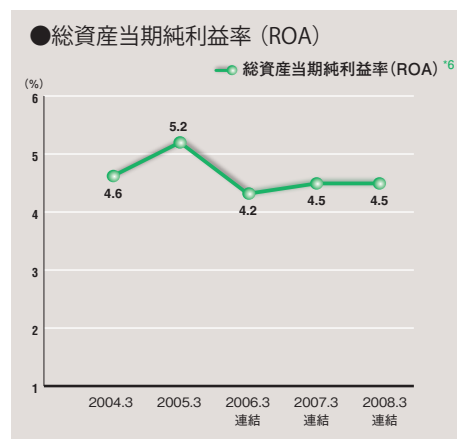
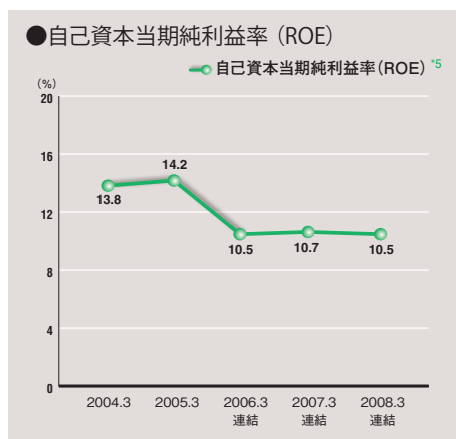
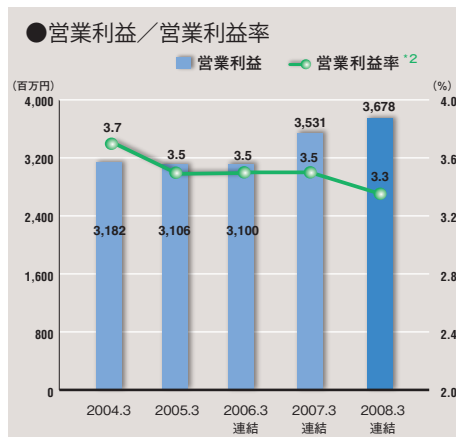
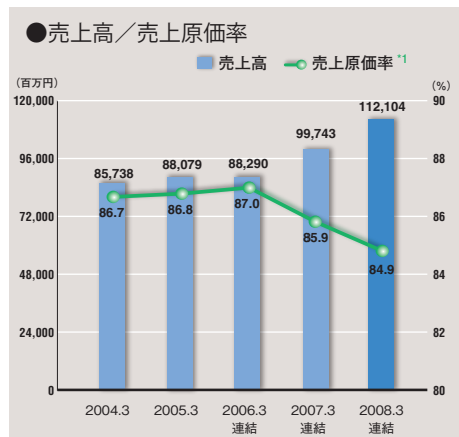
(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

データ編



財務データ

収益性



※ 2006年3月期より連結決算となっております。

	2004.3	2005.3	2006.3 連結	2007.3 連結	2008.3 連結
売上高 (百万円)	85,738	88,079	88,290	99,743	112,104
売上原価率 (%) *1	86.7	86.8	87.0	85.9	84.9
営業利益 (百万円)	3,182	3,106	3,100	3,531	3,678
営業利益率 (%) *2	3.7	3.5	3.5	3.5	3.3
経常利益 (百万円)	2,952	2,820	2,630	3,245	3,849
経常利益率 (%) *3	3.4	3.2	3.0	3.3	3.4
当期純利益 (百万円)	1,680	1,916	1,537	1,876	2,193
当期純利益率 (%) *4	2.0	2.2	1.7	1.9	2.0
自己資本当期純利益率 (ROE) (%) *5	13.8	14.2	10.5	10.7	10.5
総資産当期純利益率 (ROA) (%) *6	4.6	5.2	4.2	4.5	4.5

*1. 売上原価率＝売上原価÷売上高

*2. 営業利益率＝営業利益÷売上高

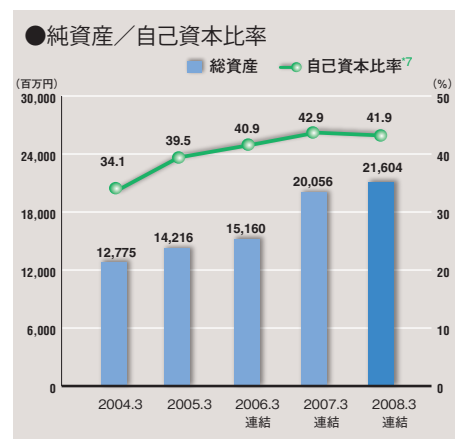
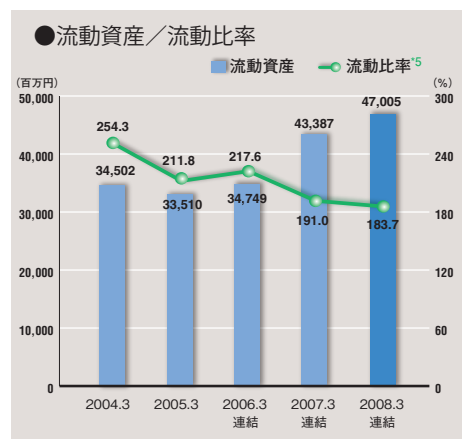
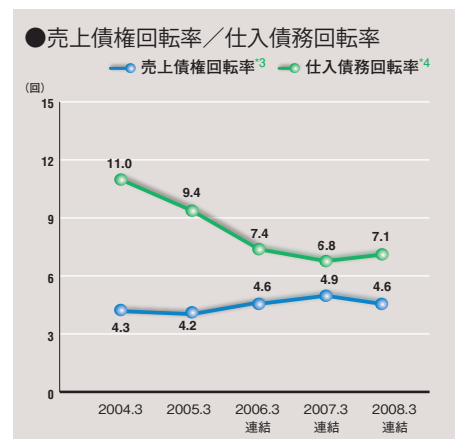
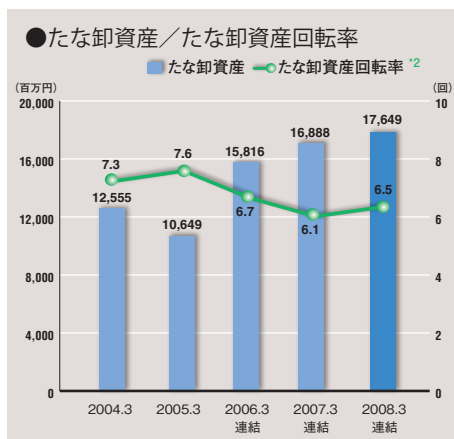
*3. 経常利益率＝経常利益÷売上高

*4. 当期純利益率＝当期純利益÷売上高

*5. 自己資本当期純利益率 (ROE)＝当期純利益÷期首・期末平均株主資本

*6. 総資産当期純利益率 (ROA)＝当期純利益÷期首・期末平均総資産

効率性・安全性



※ 2006年3月期より連結決算となっております。

	2004.3	2005.3	2006.3 連結	2007.3 連結	2008.3 連結
総資産 (百万円)	37,424	35,988	37,088	46,729	51,458
総資産回転率 (回) *1	2.4	2.4	2.5	2.4	2.3
たな卸資産 (百万円)	12,555	10,649	15,816	16,888	17,649
たな卸資産回転率 (回) *2	7.3	7.6	6.7	6.1	6.5
売上債権回転率 (回) *3	4.3	4.2	4.6	4.9	4.6
仕入債務回転率 (回) *4	11.0	9.4	7.4	6.8	7.1
流動資産 (百万円)	34,502	33,510	34,749	43,387	47,005
流動比率 (%) *5	254.3	211.8	217.6	191.0	183.7
負債総額 (百万円)	24,649	21,772	21,928	26,673	29,853
負債比率 (%) *6	192.9	153.2	144.6	133.0	138.3
純資産 (百万円)	12,775	14,216	15,160	20,056	21,604
自己資本比率 (%) *7	34.1	39.5	40.9	42.9	41.9

*1. 総資産回転率＝売上高÷期首・期末平均総資産

*2. たな卸資産回転率＝売上高÷期首・期末平均たな卸資産

*3. 売上債権回転率＝売上高÷期首・期末平均(受取手形＋売掛金)

*4. 仕入債務回転率＝売上原価÷期首・期末平均買掛金

*5. 流動比率＝流動資産÷流動負債

*6. 負債比率＝負債÷株主資本

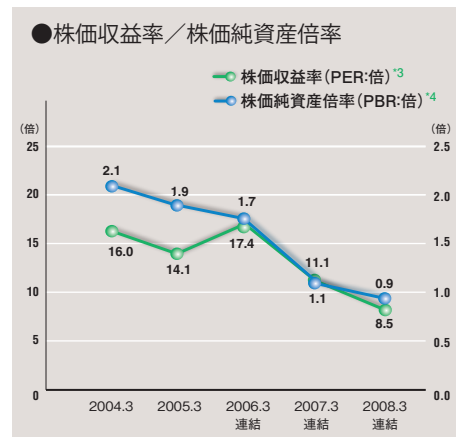
*7. 自己資本比率＝株主資本÷総資産

データ編



財務データ

■その他の指標



※ 2006年3月期より連結決算となっております。

	2004.3	2005.3	2006.3 連結	2007.3 連結	2008.3 連結
一株当たり当期純利益 (EPS: 千円) *1	35	20	16	18	20
一株当たり純資産 (千円) *2	277	154	164	189	203
株価収益率 (PER: 倍) *3	16.0	14.1	17.4	11.1	8.5
株価純資産倍率 (PBR: 倍) *4	2.1	1.9	1.7	1.1	0.9
一株当たり配当金 (円) *5	13,300	5,500	6,000	6,000	6,600
発行済株式数 (株)	46,000	92,000	92,000	106,000	106,000
配当金 (千円)	416,300	506,000	552,000	594,000	699,600
配当性向 (%) *6	25.1	26.7	36.3	31.7	31.9
従業員一人当たり当期純利益 (千円) *7	3,147	3,410	2,725	2,539	2,783
従業員数 (人)	534	562	564	739	788

*1. 一株当たり当期純利益 (EPS) = 当期純利益 ÷ 期中平均発行済株式数

*2. 一株当たり純資産 = 期末純資産 ÷ 期末発行済株式数

*3. 株価収益率 (PER) = 期末株価 ÷ 一株当たり当期純利益

*4. 株価純資産倍率 (PBR) = 期末株価 ÷ 一株当たり純資産

*5. 一株当たり配当金 = 支払済中間配当及び期末配当金 ÷ 発行済株式数

*6. 配当性向 = 支払済中間配当及び期末配当金 ÷ 当期純利益

*7. 従業員一人当たり当期純利益 = 当期純利益 ÷ 期末従業員数

会社概要

① 会社の概要 (2008年3月31日現在)

商 号	東京エレクトロン デバイス株式会社 TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED
設 立	1986年3月3日
資 本 金	2,495,750,000 円
従業員数	788 名 (連結)



神奈川県横浜市神奈川区金港町 1-4 横浜イーストスクエア

② 役員等 (2008年6月18日現在)

取締役

代表取締役社長	砂 川 俊 昭
取 締 役	久 我 宣 之
取 締 役	天 野 勝 之
取 締 役	木 村 勉
取 締 役	徳 重 敦 之
取 締 役	東 哲 郎
取 締 役	原 護
取 締 役	常 松 政 養

監査役

常 勤 監 査 役	矢 崎 一 洋
常 勤 監 査 役	遠 山 憲 一
監 査 役	田 中 健 生
監 査 役	林 田 謙 一 郎

執行役員

砂 川 俊 昭	砂 川 俊 昭
久 我 宣 之	久 我 宣 之
天 野 勝 之	天 野 勝 之
木 村 勉	木 村 勉
徳 重 敦 之	徳 重 敦 之
大 崎 弘 明	大 崎 弘 明
八 幡 浩 司	八 幡 浩 司
武 井 修 治	武 井 修 治
黒 田 信 二	黒 田 信 二
山 田 英 樹	山 田 英 樹

- (注) 1. 常松政養氏は、社外取締役であります。
2. 矢崎一洋氏及び林田謙一郎氏は社外監査役であります。

③ 拠点網 (2008年4月1日現在)

本社

本社営業部
北関東支社
大阪支社

仙台営業所 水戸営業所
立川営業所 長岡営業所
松本営業所 三島営業所
浜松営業所 名古屋営業所
京都営業所 福岡営業所
横浜オフィス

本社営業部厚木サテライト
北関東支社宇都宮サテライト
大阪支社岡山サテライト
大阪支社松山出張所

新宿オフィス
府中オフィス
大阪オフィス

仙台インレピアム開発センター
横浜インレピアム開発センター

上海華桑電子有限公司 (通称：東京エレクトロンデバイス上海)
香港華桑電子有限公司 (通称：東京エレクトロンデバイス香港)
無錫華桑電子科技有限公司 (通称：東京エレクトロンデバイス無錫)
Tokyo Electron Device Singapore Pte, Ltd.
(通称：東京エレクトロンデバイスシンガポール)

パネトロン株式会社

株式情報

① 株式の状況 (2008年3月31日現在)

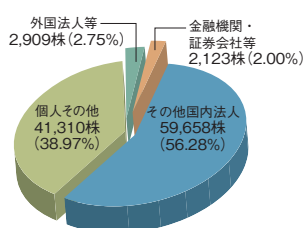
・発行可能株式総数	256,000 株
・発行済株式の総数	106,000 株
・株主数	5,955 名

② 大株主 (2008年3月31日現在)

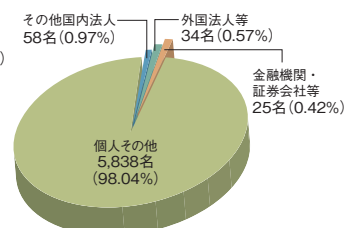
株 主 名	持株数	出資比率
	株	%
東京エレクトロン株式会社	58,753	55.42
東京エレクトロンデバイス社員持株会	3,162	2.98
小林 信 雄	1,101	1.03
ユービーエス セージー ロンドン アカウント アイビービー セグリゲイテッド クライアント アカウント	1,062	1.00
ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ノーザン トラスト ガンジー ノントリーティー クライアント	600	0.56
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	593	0.55

③ 株式分布状況 (2008年3月31日現在)

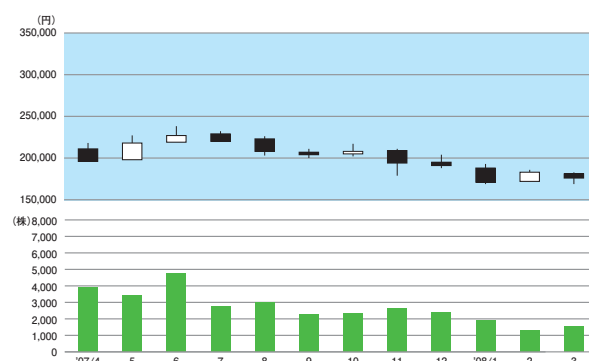
・所有者別株式数



・所有者別株主数



④ 株価と出来高



■ ホームページ

当社のホームページでは、会社案内、製品・技術情報、IR 情報など、豊富なインフォメーションを発信しています。(http://www.teldevice.co.jp/)



トップページ



IR 情報ページ

■ お問い合わせ先

広報・IR 室 E-mail : ir-info@teldevice.co.jp



東京エレクトロン デバイス株式会社

本社〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町1-4 横浜イーストスクエア
Tel,045-443-4000(代表) Fax,045-443-4050

再生紙を使用しております。



環境に配慮した「大豆油インキ」を使用しています。